



Schleif- und Polierautomat SPA



Der Schleif- und Polierautomat SPA ist Teil des MSC patentierten Verfahrens zum Anfertigen von Leiterplatten-Querschleifen. Das System ermöglicht die halbautomatische Probenpräparation zur optischen Inspektion von Durchsteigerbohrungen und Microvias. Der Schleif- und Polierautomat schleift Prüflinge wegabhängig in die angestrebte Zielebene. Der

Ablauf ist nahezu vollautomatisch bei höchster Präzision. Somit können auch Mikrobohrungen zielgenau geschliffen werden. Speziell für den Einsatz in der Leiterplattenindustrie entwickelt, vereint SPA Präzision, Reproduzierbarkeit, Zeit- und Materialeinsparung und eine optimale Qualität für die optische Begutachtung.

Technische Beschreibung:

- Platzsparendes Design, passt auf übliche Laborbänke
- Grob-, Feinschleifen und Polieren auf einer Maschine
- NC-Steuerung mit frei programmierbarer z-Achse, Drehgeschwindigkeiten, Kräften und Ablauf, Parametersatz abrufbar auf Knopfdruck
- Bedienung über Touch Screen mit Wahl der Bediensprache
- Anschlagloses Schleifen
- Materialersparnis (Harz, Schleifpapier, Suspensionen)
- Wasser- und Poliermitteldosierung automatisch
- Warnhinweis zum rechtzeitigen Wechsel der Schleifpapiere
- Schnelle und sichere Präparation auch durch ungeübtes Personal
- Hohe Kapazität, bis zu 120 Präparationen pro Schicht

Technische Daten:

- Elektrisch: 230 VAC, 50 Hz
- Gewicht: 45 kg
- Abmessungen: 900 x 500 x 450 mm (LxBxH)
- Scheibendurchmesser: 200 mm
- Wasserversorgung: max. 8 bar

Anmerkung: Für einen standardisierten Prozess mit hoher Genauigkeit und optimaler Kapazität wird der Einsatz der Trennsägemaschine TSM empfohlen in Kombination mit der SPA. Das patentierte System ermöglicht das Einbetten von Prüflingen ohne aufwändige Registrierhilfen. Die Probengewinnung sollte stets durch Fräsen erfolgen, um eine Beschädigung des Leiterplattenaufbaus zu vermeiden. Weitere Informationen siehe Datenblätter von OSR und TSM.

11.05.2017(2) / 18.11.2015